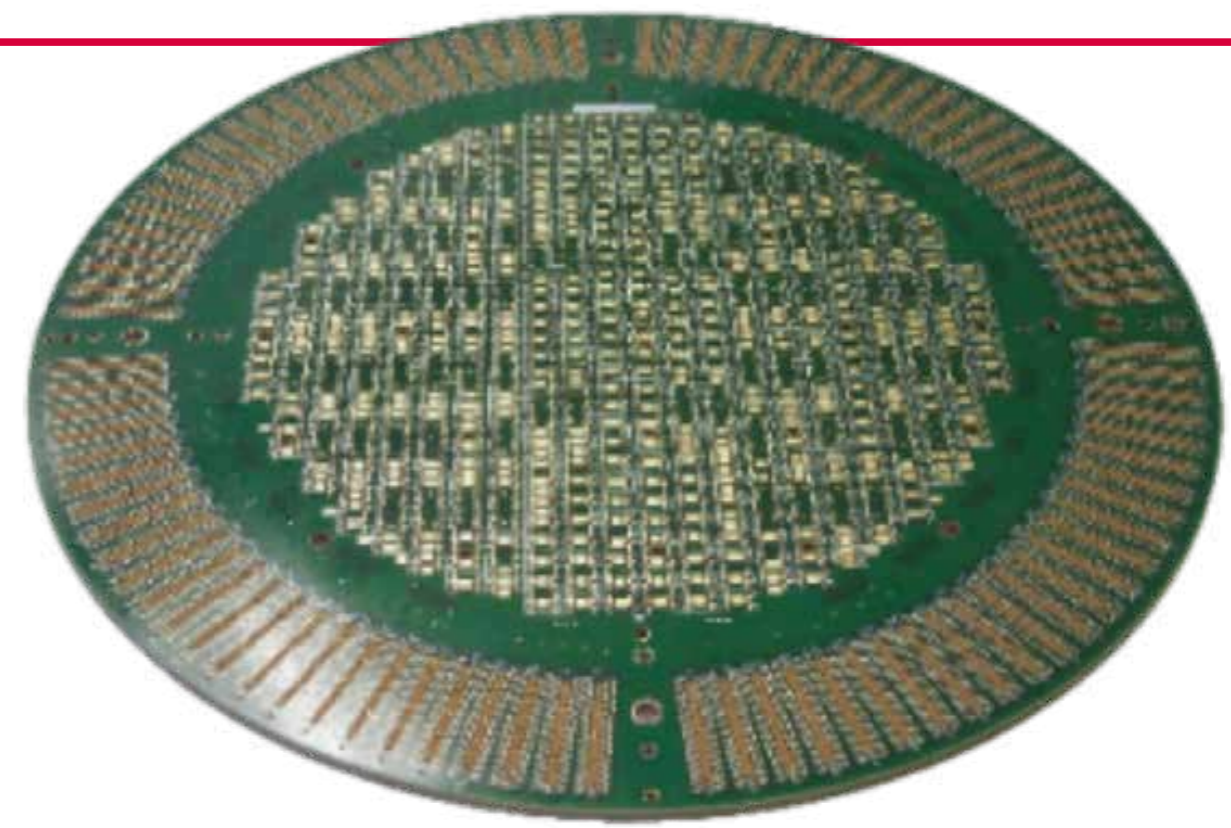


最先端LSIテストへの取り組み

大容量・高速伝送、低消費電力に対応した新技術で
お客様のイノベーションに貢献します

全層IVHプリント配線板技術 F-ALCS (エフアルシス)

- 圧倒的な配線収容力と短納期化を実現
- ▶ メッキレスのペースト印刷で金属間結合し、Via形成
- ▶ 超多層IVH基板を一括積層で実現
- ▶ 一般材から低損失材まで多くの材料選択が可能



メモリ用有機プローブカード基板

高速伝送特性の向上

>5GHzの高速試験を可能に

オープンスタブが発生しない全層IVH技術と、
狭ピッチコンタクトで高速伝送を実現



全層F-ALCS 50層基板

プロセス・ステップ数削減

50%削減 (10→5ステップ)

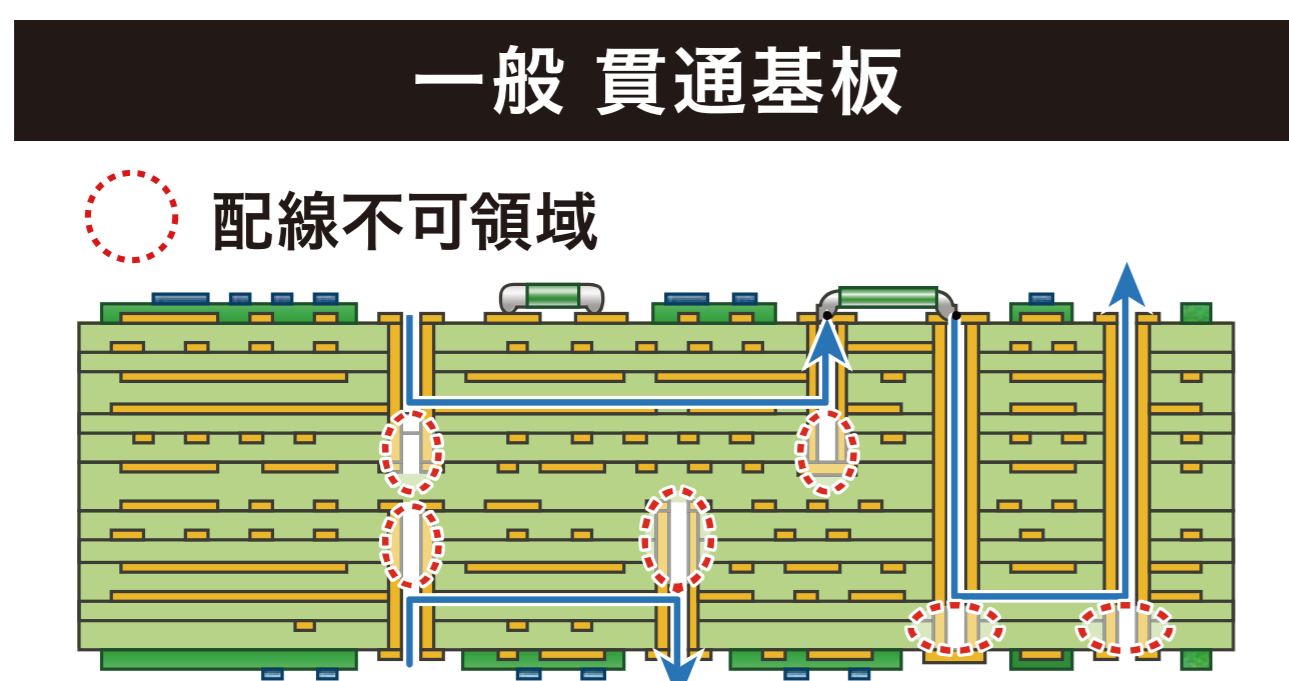
メッキ不要なVIA形成と、
一括積層で工程数を半減



配線効率の飛躍的向上

層数を43%減少(90層→52層)

必要な場所/層だけにViaを配置可能で、オープンスタブが発生せず配線効率が向上



貫通構造	全層IVH
90層	52層
板厚 8.0mm	板厚 6.2mm
基板サイズ Φ480mm	
配線数 26,300 wire(信号)	

